(19) **日本国特許庁(JP)**

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2020-71476 (P2020-71476A)

(43) 公開日 令和2年5月7日(2020.5.7)

(51) Int.Cl.			F 1		テーマコード (参考)
G02F	1/1341	(2006.01)	GO2F	1/1341	2H189
G02F	1/1337	(2006.01)	GO2F	1/1337	2H29O
GO2F	1/1334	(2006-01)	GO 2 F	1/1334	

審査請求 未請求 請求項の数 15 OL (全 18 頁)

	田田明小 小明小 明小児の奴 15 〇七 (王 16 貞)
(21) 出願番号 特願2019-134753 (P2019-134753) (22) 出願日	(71) 出願人 502356528 株式会社ジャパンディスプレイ
(31) 優先権主張番号 特願2018-201945 (P2018-201945)	東京都港区西新橋三丁目7番1号
(32) 優先日 平成30年10月26日 (2018.10.26)	(74) 代理人 110001737
(33) 優先権主張国・地域又は機関	特許業務法人スズエ国際特許事務所
日本国(JP)	(72) 発明者 大澤 修一
	東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
	社ジャパンディスプレイ内
	(72) 発明者 今関 佳克
	東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
	社ジャパンディスプレイ内
	(72) 発明者 上條 陽一
	東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
	社ジャパンディスプレイ内
	最終頁に続く

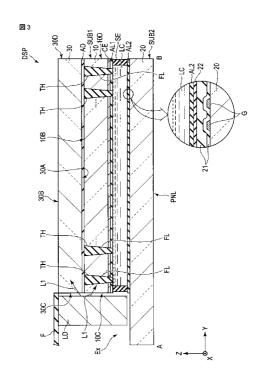
(54) 【発明の名称】表示装置

(57)【要約】 (修正有)

【解決手段】第1基板SUB1と、第1基板SUB1に対向する第2基板SUB2と、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に位置する液晶層LCと、第1基板及SUB1び第2基板SUB2のいずれか一方において、液晶層LCまで貫通した貫通孔THと、貫通孔THに充填される充填材FLと、を備える、表示装置DSP。

【課題】生産性の向上が可能な表示装置を提供する。

【選択図】図3



【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1基板と、

前記第1基板に対向する第2基板と、

前記第1基板と前記第2基板との間に位置する液晶層と、

前記第1基板及び前記第2基板のいずれか一方において、前記液晶層まで貫通した第1 貫通孔と、

前記第1貫通孔に充填される充填材と、

を備える、表示装置。

【請求項2】

前記第1基板と前記第2基板とを接着し、前記液晶層を囲むループ状に形成されるシールを備える、請求項1に記載の表示装置。

【請求項3】

画像を表示する表示部を備え、

前記表示部は、前記シールで囲まれた内側に位置し、

前記第1貫通孔は、前記表示部と前記シールとの間に位置している、請求項2に記載の表示装置。

【請求項4】

前記第1基板は、第1透明基板と、前記液晶層に接する第1配向膜と、前記第1透明基板と前記第1配向膜との間に位置する共通電極と、を備え、

前記第1貫通孔は、前記第1透明基板、前記共通電極、及び、前記第1配向膜を貫通している、請求項3に記載の表示装置。

【請求項5】

前記第2基板は、第2透明基板と、前記液晶層に接する第2配向膜と、前記第2透明基板と前記第2配向膜との間に位置する走査線と、を備え、

前記走査線は、前記表示部と前記シールとの間に延出し、前記第1貫通孔に重畳している、請求項4に記載の表示装置。

【請求項6】

第3透明基板と、接着層と、を備え、

前記接着層は、前記第1透明基板と前記第3透明基板との間に位置し、前記充填材に接 している、請求項4に記載の表示装置。

【請求項7】

前記第1基板は、前記液晶層まで貫通した第2貫通孔を備え、

前記第2貫通孔は、前記表示部に位置している、請求項4に記載の表示装置。

【請求項8】

前記第1基板は、前記液晶層まで貫通した第2貫通孔を備え、

前記第2貫通孔の幅は、前記第1貫通孔の幅とは異なる、請求項4に記載の表示装置。

【請求項9】

前記第1基板の側面に対向する発光素子を備え、

前記第1貫通孔は、前記第2貫通孔よりも前記発光素子に近接し、

前記第1貫通孔の幅は、前記第2貫通孔の幅より小さい、請求項8に記載の表示装置。

【請求項10】

前記充填材は、前記第1透明基板と同等の屈折率を有している、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の表示装置。

【請求項11】

前記第2基板は、第2透明基板と、前記液晶層に接する第2配向膜と、前記第2透明基板と前記第2配向膜との間に位置する複数の走査線と、を備え、

前記走査線は、前記表示部と前記シールとの間に延出し、

前記第1貫通孔は、隣り合う前記走査線の間に設けられ、前記第2透明基板及び前記第2配向膜を貫通している、請求項3に記載の表示装置。

10

20

30

40

【請求項12】

前記第2基板に電気的に接続される配線基板を備え、

前記シールは、前記配線基板と前記表示部との間の第1部分と、前記表示部を挟んで前記第1部分とは反対側の第2部分と、を備え、

前記第1貫通孔は、前記表示部と前記第2部分との間に設けられている、請求項3に記載の表示装置。

【請求項13】

前記充填材は、前記第2透明基板と同等の屈折率を有している、請求項11または12 に記載の表示装置。

【請求項14】

前記シールの外端面に設けられた保護部材を備えている、請求項2に記載の表示装置。

【請求項15】

表示パネルと、発光素子と、を備える表示装置であって、

前記表示パネルは、第1辺と、前記第1辺の反対側の第2辺と、を有し、

前記発光素子は、前記第1辺に沿って設けられ、

前記表示パネルは、前記第2辺に沿って形成された凹部を有し、

前記凹部には、保護部材が設けられている、表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明の実施形態は、表示装置に関する。

【背景技術】

[0002]

液晶表示装置は、一般に、一対の基板の間に液晶層を有する表示部と、表示部の周辺に位置する額縁枠と、を有している。一例では、液晶材料を注入するための注入口が表示部の一辺の全体に沿って線状に設けられた液晶表示装置が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0003]

【特許文献 1 】特開 2 0 1 3 - 3 3 1 4 2 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

本実施形態の目的は、生産性の向上が可能な表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本実施形態によれば、第1基板と、前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に位置する液晶層と、前記第1基板及び前記第2基板のいずれか一方において、前記液晶層まで貫通した第1貫通孔と、前記第1貫通孔に充填される充填材と、を備える、表示装置が提供される。

【図面の簡単な説明】

[0006]

- 【図1】図1は、本実施形態の表示装置DSPの第1構成例を示す平面図である。
- 【図2】図2は、図1に示した表示パネルPNLの一例を示す断面図である。
- 【 図 3 】 図 3 は、 図 1 に示した A B 線に沿った表示装置 D S P の断面図である。
- 【図4】図4は、表示パネルPNLの製造工程の一例を説明するための図である。
- 【 図 5 】 図 5 は、 本 実 施 形 態 の 表 示 装 置 DSPの 第 2 構 成 例 を 示 す 平 面 図 で あ る 。
- 【図6】図6は、本実施形態の表示装置DSPの第3構成例を示す平面図である。
- 【 図 7 】 図 7 は、 本 実 施 形 態 の 表 示 装 置 DSP の 第 4 構 成 例 を 示 す 平 面 図 で あ る 。
- 【図8】図8は、本実施形態の表示装置DSPの第5構成例を示す平面図である。

20

10

30

40

【図9】図9は、図8に示したE-F線に沿った表示パネルPNLの断面図である。

【図10】図10は、図8に示した領域A1を拡大した平面図である。

【図11】図11は、本実施形態の表示装置DSPの第6構成例を示す平面図である。

【図12】図12は、図11に示したG-H線に沿った表示装置DSPの断面図である。

【図13】図13は、本実施形態の表示装置DSPの第7構成例を示す平面図である。

【図14】図14は、図13に示したI- J線に沿った表示装置DSPの断面図である。

【図 1 5 】図 1 5 は、図 1 3 に示した表示装置 D S P の製造方法を説明するための図である。

【 図 1 6 】 図 1 6 は、 図 1 3 に示した表示装置 D S P の製造方法を説明するための図である。

【発明を実施するための形態】

[0007]

以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略することがある

[00008]

[第 1 構成例]

図1は、本実施形態の表示装置DSPの第1構成例を示す平面図である。一例では、第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zは、互いに直交しているが、90度以外の角度で交差していてもよい。第1方向X及び第2方向Yは、表示装置DSPを構成する基板の主面と平行な方向に相当し、第3方向Zは、表示装置DSPの厚さ方向に相当する。本明細書において、第2基板SUB2から第1基板SUB1に向かう方向を「上側」(あるいは、単に上)と称し、第1基板SUB1から第2基板SUB2に向かう方向を「下側」(あるいは、単に下)と称する。「第1部材の上の第2部材」及び「第1部材の下の第2部材」とした場合、第2部材は、第1部材に接していてもよいし、第1部材から離間していてもよい。また、第3方向Zを示す矢印の先端側に表示装置DSPを観察する観察位置があるものとし、この観察位置から、第1方向X及び第2方向Yで規定されるX-Y平面に向かって見ることを平面視という。

[0009]

本実施形態においては、表示装置DSPの一例として、高分子分散型液晶を適用した液晶表示装置について説明する。表示装置DSPは、表示パネルPNLと、配線基板1と、ICチップ2と、発光素子LDと、を備えている。

表示パネルPNLは、第1方向Xに沿って延出した一対の短辺(第1辺)E11及び短辺(第2辺)E12と、第2方向Yに沿って延出した一対の長辺E13及びE14と、を有している。表示パネルPNLは、第1基板SUB1と、第2基板SUB2と、液晶層Cと、シールSEと、を備えている。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、X・平面と平行な平板状に形成されている。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、一次で、重畳している。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、一次で、では、一次で、では、例えば、単一の熱硬化型樹脂によってループ状に形成されてもよい。液晶層LCは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に保持されてもよい。液晶層LCは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に保持された。次晶層LCは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に保持されたのでで、シールSEによって対止されている。図1において、液晶層LCを囲む矩形枠状に形成される第1方向Xに沿って延出した部分E1及びE2と、第2方向Yに沿って延出した部分E3及びE4と、を有している。部分E1乃至E4は、液晶層LCに接している。なお、シール

10

20

30

40

SEは、ループ状に形成されてもよいし、他の形状に形成されてもよい。

[0010]

図1において拡大して模式的に示すように、液晶層 L C は、ポリマー31と、液晶分子32と、を含む高分子分散型液晶を備えている。一例では、ポリマー31は、液晶性ポリマーである。ポリマー31は、第1方向 X に沿って延出した筋状に形成されている。液晶分子32は、ポリマー31の隙間に分散され、その長軸が第1方向 X に沿うように配向される。ポリマー31及び液晶分子32の各々は、光学異方性あるいは屈折率異方性を有している。ポリマー31の電界に対する応答性は、液晶分子32の電界に対する応答性より低い。

[0011]

一例では、ポリマー31の配向方向は、電界の有無にかかわらずほとんど変化しない。一方、液晶分子32の配向方向は、液晶層LCにしきい値以上の高い電圧が印加された状態では、電界に応じて変化する。液晶層LCに電圧が印加されていない状態では、ポリマー31及び液晶分子32のそれぞれの光軸は互いに平行であり、液晶層LCに入射した光は、液晶層LC内でほとんど散乱されることなく透過する(透明状態)。液晶層LCに電圧が印加された状態では、ポリマー31及び液晶分子32のそれぞれの光軸は互いに交差し、液晶層LCに入射した光は、液晶層LC内で散乱される(散乱状態)。

[0012]

表示パネルPNLは、画像を表示する表示部DAと、表示部DAを囲む額縁状の非表示部NDAと、を備えている。シールSEは、非表示部NDAに位置している。表示部DAは、第1方向X及び第2方向Yにマトリクス状に配列された画素PXを備えている。

[0013]

図1において拡大して示すように、各画素PXは、スイッチング素子SW、画素電極PE、共通電極CE、液晶層LC等を備えている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT)によって構成され、走査線G及び信号線Sと電気的に接続されている。走査線Gは、第1方向Xに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと電気的に接続されている。信号線Sは、第2方向Yに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと電気的に接続されている。画素電極PEは、スイッチング素子SWと電気的に接続されている。画素電極PEの各々は、第3方向Zにおいて共通電極CEと液対に接続されている。画素電極PEの高では、第3方向Zにおいて共通電極CEと液が、の電極PEと同電位の電極では、共通電極CEと同電位の電極に接続されている。後に説明するが、走査線Gに号線S型を表ででは、第2基板SUB2において、走査線Gは、スイッチング素子SW、及び、画素電極PEと同電位の電極の間に形成される。第2基板SUB2において、共通の分別を表であるのでは、第1基板SUB1に設けられている。第2基板SUB2において、走査線Cを表では、第1基板SUB1に設けられている。第2基板SUB2において、走査線Cを表では、第1基板SUB1に設けられている。で表示部DAとシールSEの部分E3との間、及びと表示部DAとシールSEの部分E3との間、及びと電気的に接続されている。図示を省略、信号線Sも同様に、配線基板1あるいはICチップ2と電気的に接続されている。

配線基板 1 は、第 2 基板 S U B 2 の延出部 E x に電気的に接続されている。配線基板 1 は、折り曲げ可能なフレキシブルプリント回路基板である。 I C チップ 2 は、配線基板 1 に電気的に接続されている。 I C チップ 2 は、例えば、画像表示に必要な信号を出力するディスプレイドライバなどを内蔵している。なお、 I C チップ 2 は、延出部 E x に電気的に接続されていてもよい。

[0015]

[0014]

ここで、第1基板SUB1に着目する。第1構成例では、第1基板SUB1には、液晶層LCまで貫通した複数の貫通孔THが設けられている。貫通孔THは、平面視において、シールSEに重畳せず、シールSEの内側に位置している。図1に示した例において、貫通孔THは、表示部DAとシールSEとの間の非表示部NDAに位置している。なお、表示部DA(あるいは画素PX)に重畳する貫通孔は設けられていない。貫通孔THは、部分E3と表示部DAとの間及び部分E4と表示部DAとの間において、第2方向Yに沿

10

20

30

40

って間隔を置いて並んでいる。また、平面視で、貫通孔THは、表示部DAとシールSEとの間の走査線Gに重畳している。なお、貫通孔THは、部分E1と表示部DAとの間及び部分E2と表示部DAとの間に位置していてもよい。図1に示した例において、複数の貫通孔THは、すべて同様の形状を有しているが、異なる形状の貫通孔THが含まれていてもよい。また、貫通孔THは、平面視で円形状に形成されているが、その形状は図示した例に限らず、楕円形や多角形などの他の形状に形成されていてもよい。

発光素子 L D は、短辺 E 1 1 に沿って設けられ、延出部 E x に重畳している。複数の発 光素子 L D は、第 1 方向 X に沿って間隔をおいて並んでいる。

[0016]

図2は、図1に示した表示パネルPNLの一例を示す断面図である。

第2基板SUB2は、透明基板20と、絶縁膜21及び22と、容量電極23と、スイッチング素子SWと、画素電極PEと、配向膜AL2と、を備えている。第2基板SUB2は、さらに、図1に示した走査線G及び信号線Sを備えている。透明基板20は、主面(下面)20Aと、主面20Aの反対側の主面(上面)20Bと、を備えている。主面20A及び20Bは、X・Y平面とほぼ平行な面である。スイッチング素子SWは、主面20B側に配置されている。絶縁膜21は、スイッチング素子SWを覆っている。なお、図1に示した走査線G及び信号線Sは、透明基板20と絶縁膜21との間に位置している。容量電極23は、絶縁膜21及び22の間に位置している。画素電極PEは、絶縁膜22と配向膜AL2との間において、画素PX毎に配置されている。画素電極PEは、容量電極23の開口部OPを介してスイッチング素子SWと電気的に接続されている。画素電極PEは、絶縁膜22を挟んで、容量電極23と重畳し、画素PXの容量CSを形成している。配向膜AL2は、画素電極PEを覆っている。

[0017]

第1基板SUB1は、透明基板10と、共通電極CEと、配向膜AL1と、を備えている。透明基板10は、主面(下面)10Aと、主面10Aの反対側の主面(上面)10Bと、を備えている。主面10A及び10Bは、X-Y平面とほぼ平行な面である。透明基板10の主面10Aは、透明基板20の主面20Bと向かい合っている。共通電極CEは、主面10A側に配置されている。共通電極CEは、複数の画素PXに亘って配置されている。共通電極CEは、容量電極230電位と同電位である。配向膜AL1は、共通電極CEを覆っている。

[0018]

液晶層 L C は、第 1 基板 S U B 1 と第 2 基板 S U B 2 との間に位置し、配向膜 A L 1 及び A L 2 のそれぞれに接している。

透明基板10及び20は、ガラス基板やプラスチック基板などの絶縁基板である。絶縁膜21は、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化物、アクリル樹脂などの透明な絶縁材料によって形成されている。一例では、絶縁膜21は、無機絶縁膜及び有機絶縁膜を含んでいる。絶縁膜22は、シリコン窒化物などの無機絶縁膜である。容量電極23、画素電極PE、及び、共通電極CEは、インジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)などの透明導電材料によって形成された透明電極である。配向膜AL1及びAL2は、X・Y平面に略平行な配向規制力を有する水平配向膜である。一例では、配向膜AL1及びAL2は、第1方向Xに沿って配向処理されている。なお、配向処理とは、ラビング処理であってもよいし、光配向処理であってもよい。

[0019]

図 3 は、図 1 に示した A - B 線に沿った表示装置 D S P の断面図である。表示装置 D S P は、表示パネル P N L の他に、透明基板 3 0 を備えている。

透明基板30は、主面(下面)30Aと、主面30Aの反対側の主面(上面)30Bと、側面30Cと、側面30Cの反対側の側面30Dと、を備えている。主面30A及び30Bは、X-Y平面とほぼ平行な面である。主面30Aは、透明基板10の主面10Bと向かい合っている。主面30Bは、例えば空気層に接している。側面30Cは、透明基板10の側面10Cに重畳している。側面30Dは、透明基板10の側面10Dに重畳して

10

20

30

40

いる。透明基板 3 0 は、透明な接着層 A D によって透明基板 1 0 に接着されている。接着層 A D は、主面 3 0 A 及び主面 1 0 B に接している。

[0020]

発光素子LDは、第2方向Yにおいて、側面10C及び30Cに対向している。発光素子LDは、配線基板Fに電気的に接続されている。発光素子LDは、例えば、発光ダイオードであり、詳述しないが、赤発光部、緑発光部、及び、青発光部を備えている。発光素子LDから出射される光L1は、第2方向Yを示す矢印の向きに沿って進行し、側面10C及び30Cから表示パネルPNLに入射する。なお、発光素子LDと、側面10C及び30Cとの間に、透明な導光体が配置されてもよい。

[0021]

第1構成例において、貫通孔THは、透明基板10、共通電極CE、及び、配向膜AL1を貫通している。貫通孔THは、第3方向Zに沿って透明基板30から透明基板20に向かって先細りしている、テーパー状に形成されている。貫通孔THの直下の第2基板SUB2においては、拡大して示すように、透明基板20と配向膜AL2との間に位置する走査線Gが配置されている。

貫通孔THには、充填材FLが充填されている。充填材FLは、透明であり、透明基板10と同等の屈折率を有する材料によって形成されている。充填材FLは、接着層AD及び液晶層LCに接している。

[0022]

屈折率に関して、透明基板10及び30と、充填材FLと、接着層ADとの各々の屈折率は、同等である。ここでの「同等」とは、屈折率差がゼロの場合に限らず、屈折率差が0.03以下の場合を含む。これにより、表示パネルPNLに入射した光L1の、接着層AD及び充填材FLにおける不所望な散乱や反射を抑制することができる。なお、透明基板20も、透明基板10などと同等の屈折率を有していてもよい。

[0 0 2 3]

図4は、表示パネルPNLの製造工程の一例を説明するための図である。

まず、図4(A)に示すように、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間にスペースSPを形成した状態で、第1基板SUB1及び第2基板SUB2をシールSEで貼り合せる。その後、図4(B)に示すように、第1基板SUB1に複数の貫通孔THを形成する。貫通孔THは、スペースSPまで貫通している。このような貫通孔THは、例えば、第1基板SUB1にレーザー光を照射することで形成されてもよいし、透明基板10をエッチングすることによって形成されてもよいし、レーザー照射及びエッチングを組み合わせてもよい。

その後、図4(C)に示すように、貫通孔THからスペースSPに液晶材料を注入する。このとき、複数の貫通孔THから液晶材料を同時に注入することができる。つまり、貫通孔THは、液晶材料を注入するための注入孔として機能する。また、少なくとも1つの貫通孔THは、排気孔として機能する場合がある。すなわち、大気中で液晶材料を注入する場合、スペースSPに空気が留まると、液晶材料の注入が阻害される。少なくとも1つの貫通孔THが排気孔である場合、液晶材料の注入に伴ってスペースSPの空気が貫通孔THが排気されるため、スムースに液晶材料を注入することができる。注入された液晶材料は、スペースSPの全域に広がる。液晶材料に含まれるモノマー及び液晶分子は、図2に示した配向膜AL1及びAL2の配向規制力によって第1方向Xに沿って配向する。その後、紫外線が照射されることにより、モノマーが重合し、第1方向Xに沿って延出した筋状のポリマーが形成される。

その後、図4(D)に示すように、貫通孔THに充填材FLを充填する。充填材FLは 例えば紫外線硬化型樹脂であり、紫外線が照射されることで硬化する。

[0024]

以上説明した本実施形態の注入方式は、シールSEに設けられた一つの注入孔から真空状態で液晶材料を注入する注入方式と比較して、液晶材料の注入時間を短縮することができ、生産性を向上することができる。すなわち、シールSEに注入孔が設けられる場合、

10

20

30

40

注入孔の第3方向 Z に沿った長さは、液晶層 L C の第3方向 Z に沿った厚さ(数 μ m)より大きく拡張することはできない。これに対して、本実施形態の貫通孔 T H は、液晶層 L C の厚さより大きな幅を有するように形成することができる。例えば、非表示部 N D A に設けられる貫通孔 T H D の第1方向 X に沿った間隔(数十 μ m γ 数百 μ m γ まで拡張することができる。したがって、短時間で多量の液晶材料を注入することができる。

[0025]

また、複数の貫通孔THを設けた場合には、複数の貫通孔THから同時に液晶材料を注入することができ、注入時間を短縮することができる。また、複数の貫通孔THのうち、少なくとも1つの貫通孔THが排気孔として機能する場合、液晶材料の注入が促進され、注入時間を短縮することができる。

[0026]

また、複数の貫通孔THは、表示パネルPNLの長辺E13及びE14に沿って並んで設けられている。このため、貫通孔THから注入された液晶材料が広がる際に、長辺E13及びE14に沿った方向(第2方向Y)の移動距離が短縮され、液晶材料の注入時間を短縮することができる。

[0027]

また、シールSEに設けられた注入孔を塞ぐ充填材は、平面視で、表示パネルPNLから突出する場合があったが、貫通孔THを塞ぐ充填材FLは、平面視で、表示パネルPNLから突出することはなく、非表示部NDAの額縁幅の増加を抑制できる。

図1乃至図3に示した第1構成例において、透明基板10は第1透明基板に相当し、配向膜AL1は第1配向膜に相当し、透明基板20は第2透明基板に相当し、配向膜AL2は第2配向膜に相当し、透明基板30は第3透明基板に相当し、貫通孔THは第1貫通孔に相当する。

[0028]

[第2構成例]

図5は、本実施形態の表示装置 DSPの第2構成例を示す平面図である。図5に示した第2構成例は、図1に示した第1構成例と比較して、貫通孔 THが表示パネルPNLの長辺 E13及び E14に沿って設けられているとともに短辺 E12に沿って設けられている点で相違している。すなわち、貫通孔 THは、表示部 DAとシール SEの部分 E2との間に位置し、第1方向 Xに沿って間隔をおいて並んでいる。このような貫通孔 THも、第1構成例と同様に、注入孔もしくは排気孔として機能する。

このような第2構成例においても、上記の第1構成例と同様の効果が得られる。

[0029]

[第3構成例]

図6は、本実施形態の表示装置DSPの第3構成例を示す平面図である。図6に示した第3構成例は、図1に示した第1構成例と比較して、第1基板SUB1が非表示部NDAに位置する貫通孔TH1及び表示部DAに位置する貫通孔TH2を備えている点で相違している。貫通孔TH2は、平面視において、複数の画素PX(あるいは画素電極PE)に重畳している。図6に示した例では、表示部DAに位置する貫通孔TH2は1つであるが、複数であってもよい。また、貫通孔TH2は、4つの画素PXに跨って配置されているが、4つ以上の画素PXに跨って配置されていてもよい。貫通孔TH1及びTH2の形状については、第1構成例と同様に、円形であってもよいし、他の形状であってもよい。

貫通孔TH2が注入孔である場合、貫通孔TH2からより多くの液晶材料を注入するためには、貫通孔TH2の大きさが貫通孔TH1の大きさよりも大きい場合がある。貫通孔TH2が排気孔である場合、貫通孔TH2の大きさが貫通孔TH1の大きさよりも小さい場合がある。貫通孔TH2は表示部DAに位置しているため、貫通孔TH2において不所望な散乱等に起因した表示品位の低下を抑制する観点では、貫通孔TH2は小さい方が望ましい。

このような第3構成例においても、上記の第1構成例と同様の効果が得られる。

10

20

30

40

第3構成例において、貫通孔TH1は第1貫通孔に相当し、貫通孔TH2は第2貫通孔 に相当する。

[0030]

[第4構成例]

図7は、本実施形態の表示装置DSPの第4構成例を示す平面図である。図7に示した第4構成例は、図1に示した第1構成例と比較して、第1基板SUB1が非表示部NDAに位置する貫通孔TH1及びTH2を備え、貫通孔TH1の幅が貫通孔TH2の幅とは異なる点で相違している。第2方向Yに沿って、貫通孔TH1は発光素子LDに近接し、貫通孔TH2は発光素子LDから離間している。貫通孔TH1及びTH2は、それぞれ幅W1及びW2を有している。本明細書において、幅は第1方向Xに沿った長さに相当する。幅W1は幅W2より小さい。

貫通孔TH1と貫通孔TH2との間に、他の貫通孔THが設けられる場合には、第2方向Yに沿って発光素子LDから離間していくにつれ、貫通孔THの幅が大きくなっている

[0031]

このような第4構成例においても、上記の第1構成例と同様の効果が得られる。加えて、貫通孔TH1が貫通孔TH2よりも発光素子LDに近接し、貫通孔TH1の幅W1が貫通孔TH2の幅W2より小さい。このため、貫通孔TH1における不所望な散乱等を抑制することができる。また、たとえ貫通孔TH1において不所望な散乱等が生じたとしても、目立ちにくくすることができる。

また、発光素子LDから貫通孔TH2に到達した光の輝度は、発光素子LDから貫通孔TH1に到達した光の輝度より減少しているため、貫通孔TH2における不所望な散乱等を抑制することができる。

第4構成例において、貫通孔TH1は第1貫通孔に相当し、貫通孔TH2は第2貫通孔 に相当する。

[0032]

[第5構成例]

図8は、本実施形態の表示装置DSPの第5構成例を示す平面図である。図8に示した第5構成例は、図1に示した第1構成例と比較して、第2基板SUB2が複数の貫通孔THを備えている点で相違している。つまり、上記の第1乃至第4構成例では、貫通孔TH、TH1及びTH2は、いずれも第1基板SUB1に設けられているのに対して、以下に説明する第5構成例では、貫通孔THは、第2基板SUB2に設けられている。第1構成例で説明したように、第2基板SUB2は、走査線G、信号線S、スイッチング素子SW、画素電極PE等の導電層を備えている。このため、第5構成例における貫通孔THは、これらの配線、電極、回路等の導電層を避けて設ける必要がある。つまり、貫通孔THは、導電層が比較的疎らに配置された領域に設けられる。以下に、その一例について説明する。

[0033]

第2基板SUB2において、複数の走査線G1、G2、G3…は、第1方向Xに沿って 延出し、第2方向Yに沿って約1画素PX分の間隔D1をおいて並んでいる。非表示部NDAにおいて、奇数番の走査線G1、G3、…は、シールSEの部分E3と表示部DAとの間に延出し、偶数番の走査線G2、G4、…は、シールSEの部分E4と表示部DAとの間に延出している。表示部DAと部分E3との間の構造に着目する。走査線G1及びG3の間に延出している。表示部DAと部分E3との間の構造に着目する。走査線G1及びG3の間に近いる。貫通孔THは、例えば、走査線G1及びG3の間、及び、走査線G3及びG5の間に設けられている。表示部DAと部分E4との間においても同様に、貫通孔THは、例えば、隣り合う走査線G2及びG4の間に設けられている。表示部DAと部分E3との間の領域において、配線基板1に近接する側では、表示部DAから引き出された走査線Gが密集しており、貫通孔THを設けるスペースの確保が難しいが、配線基板1から離間した側では、走査線Gが比較的疎らであり 10

20

30

40

10

20

30

40

50

、貫通孔THを設けるのに適している。表示部DAとシールSEの部分E1との間の領域においては、表示部DAから引き出された信号線Sが密集しており、貫通孔THを設けるスペースの確保が難しい。表示部DAとシールSEの部分E2との間の領域においては、配線等が比較的少なく、貫通孔THを設けるのに適している。また、図8に示した例では、表示部DAには貫通孔THが設けられていないが、数画素分の領域を滅点化して貫通孔THが設けられてもよい。

[0034]

図9は、図8に示したE-F線に沿った表示パネルPNLの断面図である。貫通孔THは、透明基板20、絶縁膜21、絶縁膜22、及び、配向膜AL2を貫通している。貫通孔THは、第3方向2に沿って透明基板20から透明基板10に向かって先細りしている、テーパー状に形成されている。貫通孔THには、充填材FLが充填されている。充填材FLは、透明であり、透明基板20と同等の屈折率を有する材料によって形成されている。充填材FLは、液晶層LC及び空気層に接している。

このような第5構成例においても、上記の第1構成例と同様の効果が得られる。

[0035]

第2基板SUB2に設けられる貫通孔THは、設置場所に合わせて適宜幅が異なっていてもよい。以下に、その一例について説明する。

図10は、図8に示した領域A1を拡大した平面図である。表示部DAとシールSEの部分E3との間において、表示部DAから引き出された走査線G1、G3、G5は、それぞれ第2方向Yに沿って延出したリード線GL1、GL3、GL5を有している。走査線G1及びG3の間に位置する貫通孔TH11は、リード線GL1と表示部DAとの間において、第1方向Xに沿って拡張されている。走査線G3及びG5の間に位置する貫通孔TH13は、リード線GL3と表示部DAとの間において、第1方向Xに沿って拡張されている。但し、リード線GL3は、リード線GL1よりも表示部DAに近接している。このため、貫通孔TH13の第1方向Xに沿った幅W13は、貫通孔TH11の第1方向Xに沿った幅W11より小さい。

[0036]

[第 6 構成例]

図11は、本実施形態の表示装置DSPの第6構成例を示す平面図である。図11に示した第6構成例は、図1に示した第1構成例と比較して、保護部材PTが設けられている点で相違している。保護部材PTは、シールSEの部分E2乃至E4の外端面に設けられている。また、保護部材PTは、表示パネルPNLの短辺E12、長辺E13及びE14に設けられている。なお、保護部材PTは、シールSEの部分E1や、表示パネルPNLの短辺E11に設けられていてもよい。保護部材PTは、例えば、上記の充填材FLと同様の透明な材料によって形成されている。あるいは、保護部材PTはテープであってもよい。

[0037]

図12は、図11に示したG-H線に沿った表示装置DSPの断面図である。保護部材PTは、短辺E12において、透明基板10の側面10D、透明基板20の側面20D、透明基板30の側面30D、及び、シールSEの外端面SOを覆っている。なお、保護部材PTは、長辺E13及びE14においても、短辺E12と同様の構造を有している。

[0 0 3 8]

このような第6構成例においては、シールSEの外端面SOが保護部材PTによって覆われているため、液晶材料を注入した際に、液晶材料からシールSEに加わる圧力によるシールSEの破損を抑制することができる。また、透明基板10乃至30の側面が保護部材PTによって覆われているため、表示装置DSPの搬送時やハンドリング時の衝撃による透明基板の破損を抑制することができる。

[0039]

保護部材PTは、透明基板10乃至30の各々の屈折率より高い屈折率を有する材料によって形成されてもよい。この場合、表示パネルPNL内を導光してきた光のうち、保護

部材 P T に向かって進行する光は、保護部材 P T と透明基板 1 0 乃至 3 0 との界面において反射され、表示パネル P N L 内に戻される。これにより、光の利用効率を改善することができる。

[0040]

[第7構成例]

図13は、本実施形態の表示装置 DSPの第7構成例を示す平面図である。図13に示した第7構成例は、図1に示した第1構成例と比較して、表示パネルPNLの短辺 E12に沿って凹部 CCが形成され、この凹部 CCに保護部材 PTが設けられている点で相違している。保護部材 PTは、シール SEの部分 E2に接している。凹部 CCは、平面視において、第2方向 Yに沿って、部分 E2と短辺 E12との間に形成されている。保護部材 PTの例は、第6構成例で説明した通りである。

なお、凹部CCは、表示パネルPNLの短辺E11、長辺E13及びE14に沿って形成されもよい。これらの各辺に凹部CCが形成された場合には、各凹部CCには保護部材PTが設けられる。

[0041]

図14は、図13に示したI-J線に沿った表示装置DSPの断面図である。保護部材 PTは、短辺E12において、透明基板10の側面10D、透明基板20の側面20D、 透明基板30の側面30D、及び、シールSEの外端面SOに接している。

図14に示す例では、凹部CCに設けられた保護部材PTの外側面PTOは、第2方向Yにおいて短辺E12の位置と一致しているが、短辺E12より外側(シールSEから離間する側)に位置していてもよいし、短辺E12より内側(シールSEに近接する側)に位置していてもよい。

[0042]

このような第7構成例においても、第6構成例と同様の効果が得られる。加えて、保護部材PTは、凹部CCに設けられるため、凹部CCが形成されていない場合と比較して、保護部材PTの表示パネルPNLからの突出幅を小さくすることができ、表示装置DSPの狭額縁化が可能となる。また、表示装置DSPの外形の拡大が抑制されるため、表示装置DSPを容易に電子機器に組み込むことができる。

[0043]

次に、第7構成例で説明した表示装置DSPの製造方法の一例について図15及び図16を参照しながら説明する。なお、図15及び図16では、表示パネルPNLの主要部のみを図示している。

[0044]

まず、図15の(A)に示すように、例えば研磨装置100を用いて、表示パネルPNLを短辺E12に沿って研磨する。このとき、透明基板10、20、30、シールSE、接着層ADなどが削られる。これにより、図15の(B)に示すように、短辺E12に沿った凹部CCが形成される。その後、塗布装置200を用いて、凹部CCに向けて液状の樹脂材料201を塗布し、この樹脂材料201の硬化処理を行う。図15の(C)に示すように、硬化した樹脂材料201は、上述した保護部材PTに相当する。図15の(C)に示す例では、保護部材PTは、その外側面PTOが短辺E12よりも外側に突出している。保護部材PTの短辺E12からの突出幅W10は、凹部CCが形成されていない場合と比較して小さくすることができる。

[0045]

図16に示す工程は、突出幅W10をさらに小さくすることを目的として、図15に示す工程に、必要に応じて追加することができるものである。

すなわち、図16の(A)に示すように、例えば研磨装置300を用いて、保護部材PTを研磨する。このとき、短辺E12から突出した保護部材PTが削られる。これにより、図16の(B)に示すように、保護部材PTの短辺E12からの突出幅W10が図15の(C)に示す例よりも小さくなる。突出幅W10は、ゼロにすることも可能である(保護部材PTの外側面PTOが短辺E12に面一となる)。

10

20

30

[0046]

以上説明したように、本実施形態によれば、生産性の向上が可能な表示装置を提供することができる。

[0047]

なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

[0048]

本明細書にて開示した構成から得られる表示装置の一例を以下に付記する。

(1)

第1基板と、

前記第1基板に対向する第2基板と、

前記第1基板と前記第2基板との間に位置する液晶層と、

前記第1基板及び前記第2基板のいずれか一方において、前記液晶層まで貫通した第1 貫通孔と、

前記第1貫通孔に充填される充填材と、

を備える、表示装置。

(2)

前記第1基板と前記第2基板とを接着し、前記液晶層を囲むループ状に形成されるシールを備える、(1)に記載の表示装置。

(3)

画像を表示する表示部を備え、

前記表示部は、前記シールで囲まれた内側に位置し、

前記第1貫通孔は、前記表示部と前記シールとの間に位置している、(2)に記載の表示装置。

(4)

前記第1基板は、第1透明基板と、前記液晶層に接する第1配向膜と、前記第1透明基板と前記第1配向膜との間に位置する共通電極と、を備え、

前記第1貫通孔は、前記第1透明基板、前記共通電極、及び、前記第1配向膜を貫通している、(3)に記載の表示装置。

(5)

前記第2基板は、第2透明基板と、前記液晶層に接する第2配向膜と、前記第2透明基板と前記第2配向膜との間に位置する走査線と、を備え、

前記走査線は、前記表示部と前記シールとの間に延出し、前記第1貫通孔に重畳している、(4)に記載の表示装置。

(6)

第3透明基板と、接着層と、を備え、

前記接着層は、前記第1透明基板と前記第3透明基板との間に位置し、前記充填材に接している、(4)に記載の表示装置。

(7)

前記第1基板は、前記液晶層まで貫通した第2貫通孔を備え、

前記第2貫通孔は、前記表示部に位置している、(4)に記載の表示装置。

(8)

前記第1基板は、前記液晶層まで貫通した第2貫通孔を備え、

前記第2貫通孔の幅は、前記第1貫通孔の幅とは異なる、(4)に記載の表示装置。

(9)

前記第1基板の側面に対向する発光素子を備え、

10

20

30

40

前記第1貫通孔は、前記第2貫通孔よりも前記発光素子に近接し、

前記第1貫通孔の幅は、前記第2貫通孔の幅より小さい、(8)に記載の表示装置。

(10)

前記充填材は、前記第1透明基板と同等の屈折率を有している、(1)乃至(9)のいずれか1項に記載の表示装置。

(11)

前記第2基板は、第2透明基板と、前記液晶層に接する第2配向膜と、前記第2透明基板と前記第2配向膜との間に位置する複数の走査線と、を備え、

前記走査線は、前記表示部と前記シールとの間に延出し、

前記第1貫通孔は、隣り合う前記走査線の間に設けられ、前記第2透明基板及び前記第2配向膜を貫通している、(3)に記載の表示装置。

(12)

前記第2基板に電気的に接続される配線基板を備え、

前記シールは、前記配線基板と前記表示部との間の第1部分と、前記表示部を挟んで前記第1部分とは反対側の第2部分と、を備え、

前記第1貫通孔は、前記表示部と前記第2部分との間に設けられている、(3)に記載の表示装置。

(13)

前記充填材は、前記第2透明基板と同等の屈折率を有している、(11)または(12)に記載の表示装置。

(14)

前記シールの外端面に設けられた保護部材を備えている、(2)に記載の表示装置。

(15)

表示パネルと、発光素子と、を備える表示装置であって、

前記表示パネルは、第1辺と、前記第1辺の反対側の第2辺と、を有し、

前記発光素子は、前記第1辺に沿って設けられ、

前記表示パネルは、前記第2辺に沿って形成された凹部を有し、

前記凹部には、保護部材が設けられている、表示装置。

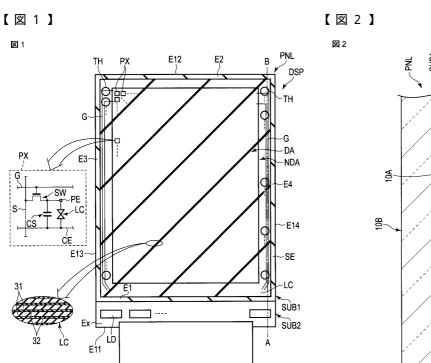
【符号の説明】

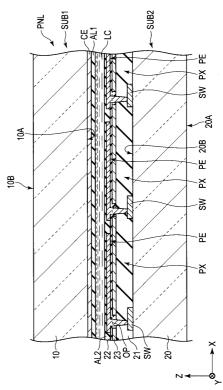
[0049]

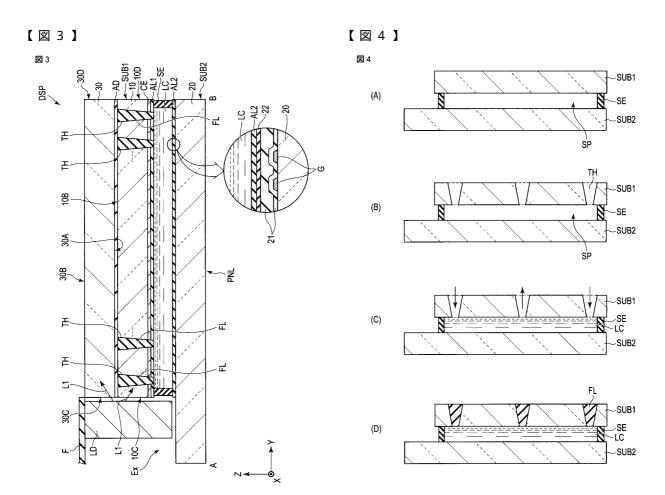
DSP...表示装置PNL...表示パネルSUB1...第1基板SUB2...第2基板10、20、30...透明基板TH...貫通孔LD...発光素子AL...配向膜FL...充填剤FT...保護部材

20

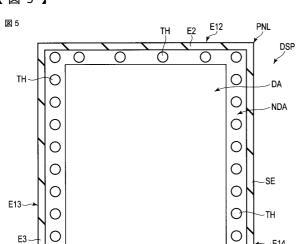
10







【図5】



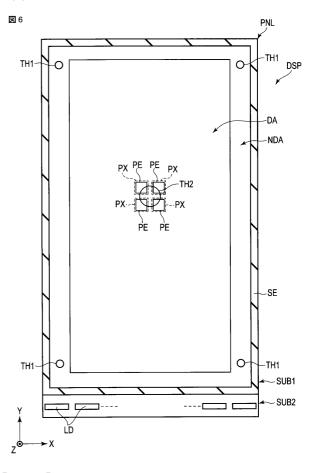
0

0

0

0

【図6】



【図7】

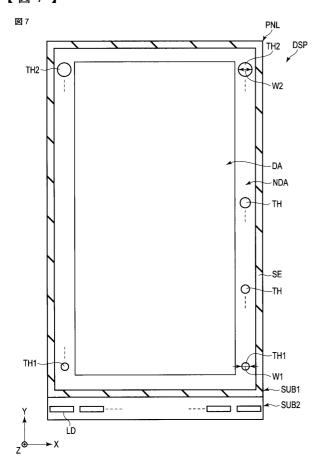
0

0

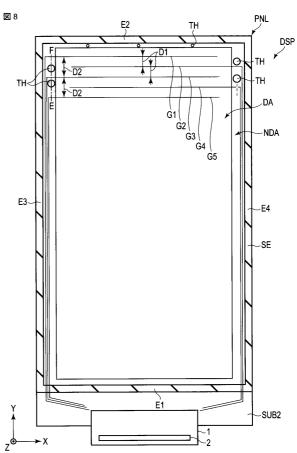
0

0

Éx

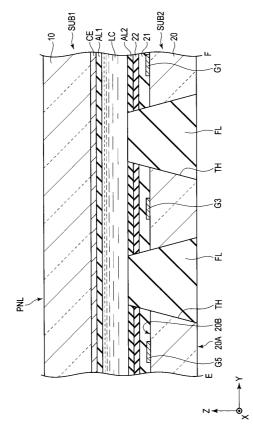


【図8】



【図9】

図 9

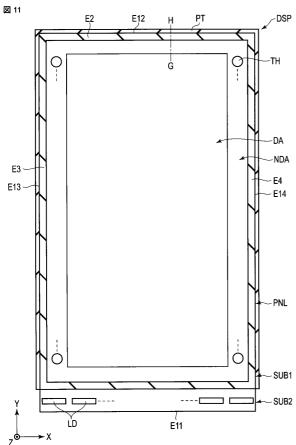


【図10】

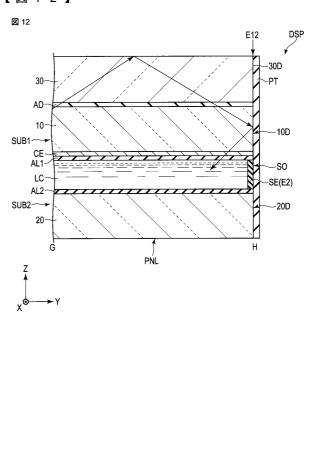
E3
SUB2
W13
D2
GL1 GL3 GL5

X

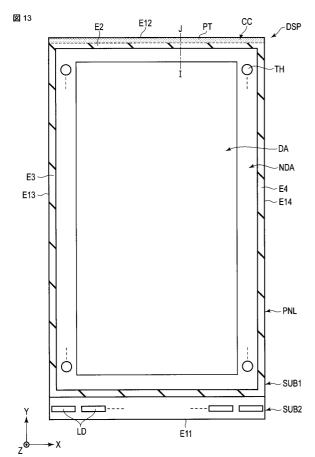
【図11】



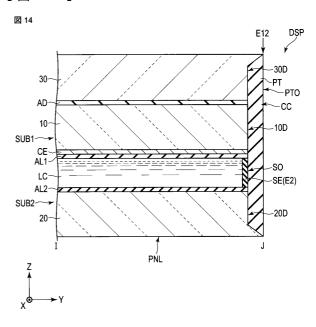
【図12】



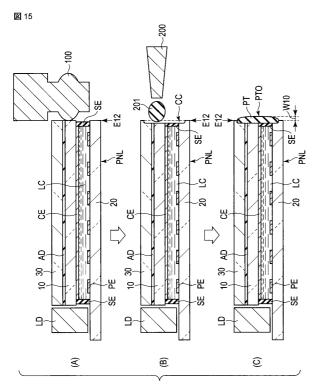
【図13】



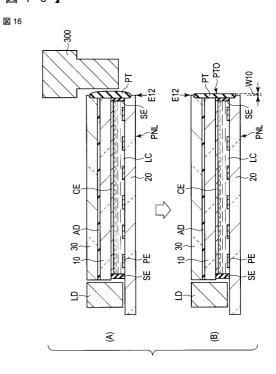
【図14】



【図15】



【図16】



フロントページの続き

(72)発明者 渡辺 義弘

東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会社ジャパンディスプレイ内

(72)発明者 宮坂 光一

東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会社ジャパンディスプレイ内

Fターム(参考) 2H189 AA04 AA58 AA64 BA04 CA08 DA52 DA53 DA55 DA61 DA62

DA64 EA04Z FA20 FA81 HA02 HA11 HA12 JA04 LA05 LA10

2H290 AA03 AA85 BF13 BF23 CA34



/DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/F	专利名称(译)	显示装置				
「「「「「「「「「「「「「「「「」」」」」」 株式会社日本显示器	公开(公告)号	JP2020071476A	公开(公告)日	2020-05-07		
申请(专利权)人(译) 有限公司日本显示器 [标]发明人 大澤修一 今閱住克 上條陽一 渡辺義弘 宮坂光一 发明人 大澤修一 今閱住克 上條陽一 渡辺義弘 宮坂 美山 宮坂 光一 IPC分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 FI分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 F-TERM分类号 2H189/AA04 2H189/AA58 2H189/AA64 2H189/BA04 2H189/CA08 2H189/DA52 2H189/DA53 2H /DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/FA11 2H189/HA11 2H189/HA12 2H189/JA04 2H189/LA05 2H189/LA10 2H290/AA03 2H290/AA85 2H29	申请号	JP2019134753	申请日	2019-07-22		
大澤修一 今関住克 上條陽一 渡辺義弘 宮坂光一 大澤修一 今関住克 上條 陽一 渡辺 義弘 宮坂 光一 PC分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 F-TERM分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 F-TERM分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334	[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日本显示器				
今関住克 上條陽一 渡辺義弘 宮坂光一 大澤 修一 今関 住克 上條 陽一 渡辺 義弘 宮坂 光一 F-TERM分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 G02F1/1334 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 G02F1/1334 G02F1/1334 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 G02F1/133	申请(专利权)人(译)	有限公司日本显示器				
今関 佳克 上條 陽一 渡辺 義弘 宮坂 光一 IPC分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 FI分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 F-TERM分类号 2H189/AA04 2H189/AA58 2H189/AA64 2H189/BA04 2H189/CA08 2H189/DA52 2H189/DA53 2H /DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/F 2H189/HA11 2H189/HA12 2H189/JA04 2H189/LA05 2H189/LA10 2H290/AA03 2H290/AA85 2H2	[标]发明人	今関佳克 上條陽一 渡辺義弘				
FI分类号 G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334 F-TERM分类号 2H189/AA04 2H189/AA58 2H189/AA64 2H189/BA04 2H189/CA08 2H189/DA52 2H189/DA53 2H /DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/HA11 2H189/HA12 2H189/JA04 2H189/LA05 2H189/LA10 2H290/AA03 2H290/AA85 2H2	发明人	今関 佳克 上條 陽一 渡辺 義弘				
F-TERM分类号 2H189/AA04 2H189/AA58 2H189/AA64 2H189/BA04 2H189/CA08 2H189/DA52 2H189/DA53 2H /DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/HA11 2H189/HA12 2H189/JA04 2H189/LA05 2H189/LA10 2H290/AA03 2H290/AA85 2H2	IPC分类号	G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334				
/DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/F 2H189/HA11 2H189/HA12 2H189/JA04 2H189/LA05 2H189/LA10 2H290/AA03 2H290/AA85 2H2	FI分类号	G02F1/1341 G02F1/1337 G02F1/1334				
	F-TERM分类号	2H189/AA04 2H189/AA58 2H189/AA64 2H189/BA04 2H189/CA08 2H189/DA52 2H189/DA53 2H189 /DA55 2H189/DA61 2H189/DA62 2H189/DA64 2H189/EA04Z 2H189/FA20 2H189/FA81 2H189/HA02 2H189/HA11 2H189/HA12 2H189/JA04 2H189/LA05 2H189/LA10 2H290/AA03 2H290/AA85 2H290 /BF13 2H290/BF23 2H290/CA34				
优先权 2018201945 2018-10-26 JP	优先权	2018201945 2018-10-26 JP				
外部链接 <u>Espacenet</u>	外部链接	Espacenet				

摘要(译)

要解决的问题:提供一种能够提高生产率的显示装置。解决方案:第一基板SUB1,与第一基板SUB1相对的第二基板SUB2,位于第一基板SUB1和第二基板SUB2之间的液晶层LC,第一基板和SUB1。 一种显示装置DSP,包括穿透到液晶层LC的通孔TH和填充在两个基板SUB2之一上的通孔TH中的填充剂FL。 [选择图]图3

